

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 10 月 6 日(06.10.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/122211 A1

- (51) 国際特許分類:
B29B 13/10 (2006.01) C08L 63/00 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/054696
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 2 日(02.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-079552 2010 年 3 月 30 日(30.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 住吉 孝文 (SUMIYOSHI Takafumi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 柴田 洋志 (SHIBATA Hiroshi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品

川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

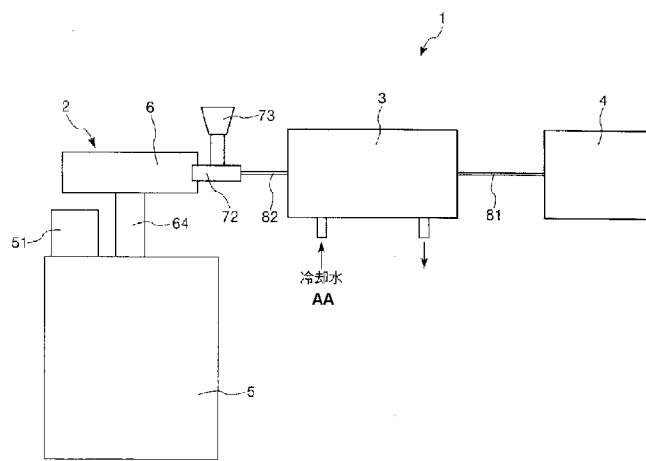
- (74) 代理人: 朝比 一夫, 外 (ASAHI Kazuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 1 8 番 9 号 西新橋ノアビル 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR FABRICATING RESIN COMPOSITION FOR SEALING SEMICONDUCTORS, AND PULVERIZER

(54) 発明の名称: 半導体封止用樹脂組成物の製造方法および粉砕装置

[図2]



AA cooling water

FIG. 2

(57) Abstract: Disclosed is a pulverizer (1) which is an airflow pulverizer provided with: a pulverizing unit (2) for pulverizing a first composition; a cooling device (3); a high-pressure air generator (4); and a storage unit (5) for storing the pulverized first composition. The pulverizing unit (2) is provided with a chamber (6), an outlet (62) which discharges the pulverized first composition is formed in the base of the chamber (6), and a wall which surrounds the periphery of the outlet (62) is formed near the outlet. A plurality of nozzles (71, 72) are disposed in the side of the chamber (6), and a supply part (73) which communicates with the inside of the nozzle (72) is disposed at the top of the nozzle (72). The pressure of air supplied inside the chamber (6) is set to 0.3 MPa or more, the temperature thereof is set to 20°C or less, and the humidity thereof is set to 40% RH or less.

(57) 要約: 粉砕装置 1 は、気流式の粉砕装置であり、第 1 の組成物を粉砕する粉砕部 2 と、冷却装置 3 と、高圧空気発生装置 4 と、粉砕された第 1 の組成物を貯留する貯留部 5 とを備えている。

る。粉砕部 2 は、チャンバ 6 を備え、チャンバ 6 の底部には、粉砕された第 1 の組成物を排出する出口 62 が形成され、出口 62 の近傍には、出口の周囲を囲う壁部が形成されている。チャンバ 6 の側部には、複数のノズル 71 とノズル 72 とが設置され、ノズル 72 の上部には、ノズル 72 内に連通する供給部 73 が設置されている。チャンバ 6 内に供給する空気の圧力を 0.3 MPa 以上、温度を 20°C 以下、湿度を 40% RH 以下に設定する。

WO 2011/122211 A1